

2017-2022年中国晶圆代工行业市场全景评估及发展趋势研究预测报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2017-2022年中国晶圆代工行业市场全景评估及发展趋势研究预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/298927.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话：400-700-0142 010-80392465

电子邮箱：kf@huaon.com

联系人：刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

报告目录：

第一章晶圆制造简介21

第一节晶圆制造流程21

第二节晶圆制造成本分析27

第二章半导体市场32

第一节2017-2022年半导体产业预测32

第二节2016年半导体市场下游预测34

第三节全球晶圆代工产业现状35

第四节全球半导体制造产业38

一、全球半导体产业概况38

二、全球晶圆代工行业概况39

第五节中国半导体产业与市场44

一、中国半导体市场44

二、中国半导体产业47

三、中国ic设计产业56

四、中国半导体产业发展趋势59

第三章晶圆代工产业简介61

第一节晶圆制造工艺简介61

第二节全球晶圆产业及主要厂商简介62

第三节中国半导体产业政策环境70

第四节中国晶圆制造业现状及预测73

第四章晶圆厂研究76(AKWZY)

一、中芯国际76

（一）企业偿债能力分析77

（二）企业运营能力分析79

（三）企业盈利能力分析82

二、上海华虹nec电子有限公司83

（一）企业偿债能力分析85

（二）企业运营能力分析87

（三）企业盈利能力分析90

三、上海宏力半导体制造有限公司92

（一）企业偿债能力分析93

（二）企业运营能力分析95

(三) 企业盈利能力分析98

四、华润微电子99

(一) 企业偿债能力分析100

(二) 企业运营能力分析102

(三) 企业盈利能力分析105

五、上海先进半导体106

(一) 企业偿债能力分析107

(二) 企业运营能力分析109

(三) 企业盈利能力分析112

六、和舰科技（苏州）有限公司113

(一) 企业偿债能力分析114

(二) 企业运营能力分析116

(三) 企业盈利能力分析119

七、bcd（新进半导体）制造有限公司120

(一) 企业偿债能力分析121

(二) 企业运营能力分析123

(三) 企业盈利能力分析126

八、方正微电子有限公司127

(一) 企业偿债能力分析128

(二) 企业运营能力分析130

(三) 企业盈利能力分析133

十、南通绿山集成电路有限公司134

(一) 企业偿债能力分析135

(二) 企业运营能力分析137

(三) 企业盈利能力分析140

十一、纳科（常州）微电子有限公司141

(一) 企业偿债能力分析144

(二) 企业运营能力分析146

(三) 企业盈利能力分析149

十二、珠海南科集成电子有限公司150

(一) 企业偿债能力分析151

(二) 企业运营能力分析153

(三) 企业盈利能力分析156

十三、康福超能半导体（北京）有限公司157

(一) 企业偿债能力分析157

- (二) 企业运营能力分析159
- (三) 企业盈利能力分析162
- 十四、科希-硅技半导体技术第一有限公司163
 - (一) 企业偿债能力分析163
 - (二) 企业运营能力分析165
 - (三) 企业盈利能力分析168
- 十五、光电子(大连)有限公司170
 - (一) 企业偿债能力分析170
 - (二) 企业运营能力分析172
 - (三) 企业盈利能力分析175
- 十六、西安西岳电子技术有限公司176
 - (一) 企业偿债能力分析177
 - (二) 企业运营能力分析179
 - (三) 企业盈利能力分析182
- 十七、吉林华微电子股份有限公司183
 - (一) 企业偿债能力分析185
 - (二) 企业运营能力分析187
 - (三) 企业盈利能力分析190
- 十八、丹东安顺微电子有限公司191
 - (一) 企业偿债能力分析191
 - (二) 企业运营能力分析193
 - (三) 企业盈利能力分析196
- 十九、敦南科技198
 - (一) 企业偿债能力分析199
 - (二) 企业运营能力分析200
 - (三) 企业盈利能力分析203
- 二十、福建福顺微电子205
 - (一) 企业偿债能力分析206
 - (二) 企业运营能力分析208
 - (三) 企业盈利能力分析211
- 二十一、杭州立昂212
 - (一) 企业偿债能力分析213
 - (二) 企业运营能力分析215
 - (三) 企业盈利能力分析218
- 二十二、杭州士兰集成电路219

(一) 企业偿债能力分析	220
(二) 企业运营能力分析	222
(三) 企业盈利能力分析	224
二十三、hynix-st半导体公司	226
(一) 企业偿债能力分析	226
(二) 企业运营能力分析	228
(三) 企业盈利能力分析	231
二十四、台积电	232
二十五、联电	237
二十六、特许	239
二十七、东部亚南dongbuanam	240
二十八、世界先进	241
二十九、jazz半导体	241
三十、magnachip	242
三十一、silterra	243
三十二、x-fab	245
三十三、stsilicon	246
三十四、towersemiconductor	246
三十五、episiltechnologies	247
三十六、ibm	247
部分图表目录：	
图表1晶圆制造工艺流程	21
图表2晶圆尺寸变化影响加工成本趋势分析	27
图表32016年度全球营收前13的晶圆代工企业	35
图表42017-2022年大陆ic内需市场规模变化与预测	36
图表5主要代工企业产能分布及收益情况	41
图表6集成电路技术节点及其对应研发和建厂费用	43
图表7全球半导体市场规模超过3000亿美元	47
图表8半导体产品种类繁多	48
图表9全球半导体分产品市场占比	48
图表10中国大陆半导体市场规模近4000亿元	49
图表11全球半导体产业区域结构发生巨大变化	50
图表12北美半导体设备制造商bb值	51
图表13半导体产业链	51
图表14近期或者未来有望在a股上市的半导体厂商	52

图表15半导体产业链上封测环节技术壁垒相对较低53
图表16封测环节在半导体产业链中的相对进入壁垒54
图表17集成电路封测行业一直占据行业主导地位55
图表18国内十大半导体封装测试企业56
图表192016年全球晶圆代工排名63
图表202012-2016年全球前三大半导体厂商营收与成长趋势64
图表21全球半导体厂商资本支出占营收比例之比较65
图表22前三大半导体厂商资本支出与占营收比例趋势66
图表23全球半导体厂商资本支出集中程度分析67
图表24半导体设备厂商于18寸晶圆生产设备投资考虑情境分析68
图表25全球半导体设备产业版图的变化69
图表26国内政策对集成电路产业大力支持71
图表27国内半导体进口金额超2000亿美元71
图表28国内集成电路未来三阶段发展目标73
图表29近3年中芯国际有限公司资产负债率变化情况77
图表30近3年中芯国际有限公司产权比率变化情况78
图表31近3年中芯国际有限公司固定资产周转次数情况79
图表32近3年中芯国际有限公司流动资产周转次数变化情况80
图表33近3年中芯国际有限公司总资产周转次数变化情况81
图表34近3年中芯国际有限公司销售毛利率变化情况82
图表35近3年上海华虹nec电子有限公司资产负债率变化情况86
更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/298927.html>